

2025년 상반기 미국 반도체 산업

U.S Semiconductor Industry Outlook H1 2025

01

2025년 상반기 산업 전경

Industry Landscape – H1 2025

02

2025년 상반기 미국 반도체 정책 변화

U.S. Semiconductor Policy Shifts – H1 2025

03

2025년 상반기 반도체 시장 수급 불균형

Supply–Demand Imbalances in the
Global Semiconductor Market

04

글로벌 주요 기업의 전략적 대응

Strategic Moves by Global Leaders

05

분석 종합 및 함의

Key Takeaways and Implications

06

참고문헌 및 출처

References & Sources

2025 상반기 반도체 산업의 전환점.

1. 2025년 상반기 반도체 산업의 전환점

미국 트럼프 2기 행정부의 출범은 반도체 산업 전반에 걸쳐 **정책적 전환을** 촉진하고 있으며, 이는 전 세계 공급망 구조와 기업 전략에 영향을 미치고 있다. 특히 미국 정부는 자국 중심의 반도체 자립 역량을 강화하고 첨단 기술 패권을 선점하기 위한 일환으로, **CHIPS Act에 대한 수정·보완 작업을 단행**하고, **대중국 수출 규제와 관세 부과 정책을 전방위적으로 확대**하고 있다.

이러한 정책 변화는 공급망의 지역화를 가속화하는 한편, **주요 기업들의 생산 거점 및 기술 투자 전략에 직접적인 방향성을 제시**하고 있다. 동시에, 인공지능(AI), 고성능 컴퓨팅(HPC), 자율주행차 및 전장산업 등 미래 성장산업의 확대에 의해 특정 반도체 수요는 지속적으로 증가하고 있으나, 범용 메모리 및 일부 시스템 반도체 분야에서는 수요 정체와 공급 과잉이 병존하는 이중 구조가 나타나고 있다.

정책 리스크와 시장 불균형이 중첩되는 현재의 산업 환경은 단기적 차원의 공급망 재조정만으로는 대응이 어려운 구조적 변화를 시사한다. 이에 따라 **반도체 기업들은 중장기적 관점에서 글로벌 사업 전략의 재정비와 기술 로드맵의 다변화를 본격화**하고 있다.

엔비디아(NVIDIA), 아마존(Amazon), 브로드컴(Broadcom), 구글(Google), TSMC 등 주요 기업들은 미국 정부의 정책 방향에 능동적으로 대응하며, 생산시설 투자 확대, 기술 고도화, 대중국 전략 수정 등 다양한 전략적 조치를 실행 중이다.

02.

2025년 상반기 미국 반도체 정책 변화

Realignment

재설정

선별적 정부지원과
민간 AI 인프라 확장

Regulation

규제

대중국 반도체
수출통제 강화와
글로벌 공급망 영향

Tariff

관세

고율 관세
도입과 글로벌
공급망 이동

선별적 정부지원과 민간 AI 인프라 확장.

2.1. 선별적 정부지원과 민간 AI 인프라 확장

2025년 상반기, 미국 트럼프 행정부는 반도체 산업의 경쟁력 강화를 위해 **‘선별적 정부지원’**과 **‘민간 주도 인프라 확장’**을 병행하는 새로운 정책 기조를 본격적으로 추진하였다. 이는 기존의 제조 팹 중심 산업 지원에서 AI 컴퓨팅 및 에너지 인프라 등 운영 기반까지 정책 지평을 확장함으로써, 전략적 균형 재설정에 방점을 두고 있다는 점에서 큰 의미가 있다.

2025년 6월 4일, 트럼프 행정부는 바이든 행정부 시기 체결된 CHIPS and Science Act 보조금 계약에 대해 전면 재검토에 나섰다. 상무부 장관 하워드 루트닉은 일부 과도하게 관대했던 보조금 조건을 수정했다고 밝히며, 대표적 사례로 TSMC에는 기존 60억 달러 보조금 대신 자체 자본지출(CapEx) 1,000억 달러 추가 확대를 요구했다. 반면, 인텔의 180억 달러 오하이오 신규 팹 프로젝트는 정부의 승인을 받지 못하고, 예산 재검토 등의 이유로 착공이 2026년 상반기로 연기되었다【Reuters, 2025.06.04】. 이 같은 조치는 **미국 정부가 무차별적 보조금 지급에서 전략적 선별지원을 통해 민간 투자의 레버리지를 극대화하려는** 방향으로 기조를 전환했음을 보여준다.

02. 2025년 상반기 미국 반도체 정책 변화

이와 동시에, 트럼프 행정부는 AI 컴퓨팅 인프라 확충을 위해 민간 중심의 대규모 프로젝트를 본격화했다. 2025년 1월 공식 발표된 'Stargate 프로젝트'는 OpenAI, SoftBank, Oracle, MGX 등이 참여하는 민간 컨소시엄으로 구성되어, 향후 4년간 5,000억 달러를 투입해 미국 전역에 AI 전용 데이터센터와 전력·냉각 인프라를 구축할 계획이다. 이를 통해 미국의 AI 리더십을 공고히 하겠다는 정부의 의지가 강조되었다【TechTarget, 2025.02.20】.

이어 7월 15일, '펜실베이니아 에너지·혁신 서밋'에서는 Google, Blackstone, CoreWeave, FirstEnergy 등 민간 기술·에너지 대기업이 총 920억 달러 규모의 AI 및 에너지 인프라 투자 계획을 발표하며, 공공-민간 파트너십을 통한 산업기반 강화가 본격적으로 확대되고 있음을 보여주었다. 이처럼, 2025년 상반기 미국 반도체 정책은 CHIPS Act 보조금의 조건부 매칭 펀딩화를 통해 제조시설 투자 효율성을 재조정하고, 동시에 민간 주도의 컴퓨팅 및 에너지 인프라 확장을 적극적으로 유도함으로써 '제조(capability)'와 '운영 기반(compute & power)' 간의 균형 잡힌 산업 전략으로 진화하고 있다【White House, 2025.07.15; 2025.07.16】.



Pennsylvania Energy and Innovation Summit (Photo: EPA)

대중국 반도체 수출통제 강화와 글로벌 공급망 영향.

2.2. 대중국 반도체 수출통제 강화와 글로벌 공급망 영향

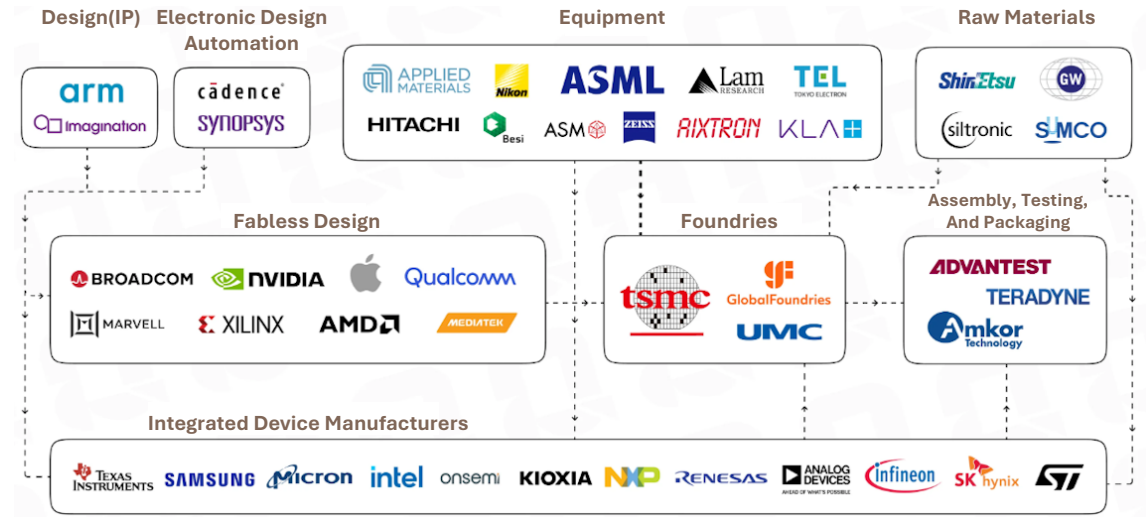
2025년 2월 14일, 미국 상무부는 AI 반도체, 선진 패키징, EUV/DUV 노광장비 등 전략 기술에 대한 대중국 수출을 전면적으로 제한하는 새로운 가이드라인을 발표하였다【US Department of Commerce, 2025.02.14】. 이 같은 조치는 미국 정부가 기술 패권 우위를 지키기 위해, 핵심 첨단기술의 유출 차단을 한층 강화한 결과이다【US Department of Commerce, 2025.02.14】.

앞서 2025년 1월 16일, 상무부 산하 산업안보국(BIS)은 고성능 연산용 집적회로(3A090.a)에 대한 추가 실사 조치(Instrument for Further Review, IFR)를 도입했다. 이 조치는 데이터센터급 AI 칩의 글로벌 수출에 대해 개별허가 요건을 재확인하고, 파운드리와 분기별 보고, 설계 기업 및 OSAT(후공정 업체)에 대한 KYC(Know Your Customer) 요구, 적합성 확인서(Attestation) 제출 등 까다로운 절차를 추가로 부과했다.

02. 2025년 상반기 미국 반도체 정책 변화

특히 이번 규제는 **선진 패키징과 제3국 경유 우회**를 통한 중국 유출을 봉쇄하는 데 목적이 있다. 제품 성능이 기준 이하인 경우에는 확인서를 통해 합법 유통을 허용하고, 임계치를 초과하면 수출 허가 대상으로 지정하는 '이중 구조'가 적용됐다. 그러나 **말레이시아, 태국 등 제3국을 통한 우회 수출 가능성이 여전히 남아 있어, 미국 정부는 추가 규제 도입도 검토 중이다**【Bloomberg, 2025.07.04】.

결과적으로, 반복적·중첩적인 수출 통제는 미국 내 제조 역량 강화를 유도하는 한편, **글로벌 반도체 밸류체인 전반에 전략적 재협상을 촉발하고 있다**. 특히 고성능 반도체 및 패키징 기술이 규제 대상이 됨으로써, **단순 부품 이전을 넘어 설계-생산-패키징-테스트 등 공급망 각 단계의 리스크 분산과 지역 다변화가 더욱 가속화되고 있다**.



The Semiconductor Value Chain (Source: Quattr)

고율 관세 도입과 글로벌 공급망 이동.

2.3. 고율 관세 도입과 글로벌 공급망 이동

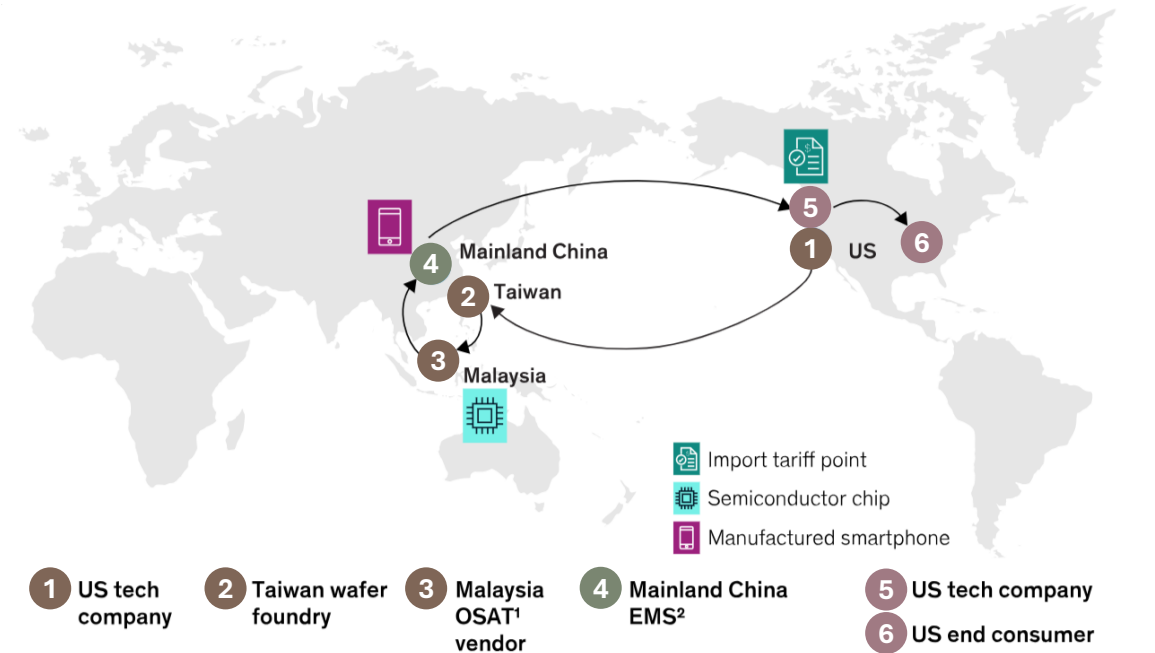
2025년 상반기, 미국 정부는 외국산 반도체가 국가 안보에 미치는 영향을 평가한다는 명분으로 무역확장법 232조 조사를 개시하고, 트럼프 대통령은 2월부터 최대 25%의 반도체 수입 관세 도입 의사를 공식화하였다. 이는 첨단 반도체의 자국 내 생산 확대와 공급망 자립을 목표로 한 것으로, **고율 관세를 핵심 정책 수단으로 활용**하는 미국의 전략이 본격화된 것이다.

이러한 관세 정책은 동맹국들과의 협상 필요성을 높였으며, 동시에 미국 내 반도체 가격 상승, 구글·오픈AI 등 빅테크 기업의 서버 구축 비용 증가, 산업 경쟁력 약화 등 부정적 파급효과를 불러왔다. 특히 관세 시행 직전에는 선발주(rush order) 수요가 급증해 2025년 1분기 글로벌 파운드리 매출 하락폭을 약 5.4%로 제한하는 단기 효과를 보였으나, 2분기부터는 수요 둔화와 공급망 재편 압력이 본격화되었다【TrendForce, 2025.06.09】.

02. 2025년 상반기 미국 반도체 정책 변화

아울러, 맥킨지(McKinsey) 보고서에 따르면, 글로벌 EMS 및 OSAT 기업들은 '최종 조립 국가' 기준으로 공급망 재배치를 가속화하고 있어, 반도체 밸류체인 전반의 구조적 이동이 시작되었음이 확인된다【McKinsey, 2025.05.27】. 이는 단기적 시장 대응을 넘어, 미국 주도의 관세 프레임워크가 중장기적으로 글로벌 반도체 생산 및 유통 구조를 근본적으로 재편하는 촉매로 작용하고 있음을 의미한다.

결국, 2025년 상반기 미국의 관세 정책은 단순한 무역조치에 그치지 않고 제조·조립·후공정 등 밸류체인 전체의 재설계를 유도하고 있다. 직접적인 관세(1차 효과)와 간접 비용(2차 효과)이라는 이중 압력 하에서, 글로벌 기업들은 투자 및 공급망 전략을 재정비하고 있으며, 이는 향후 글로벌 수요 둔화와 산업 경쟁 구도의 전환점을 가져올 가능성이 높다.



Finished-goods import example: Illustrative supply chain sub-tier journey for a smartphone (Source: McKinsey & Company)

2.4. 글로벌 반도체 공급망 변화

2025년 상반기, 미국의 대중국 수출 규제 및 고율 관세 정책은 안보 강화, 공급망 자립, 국내 투자 촉진 등 일부 긍정적인 성과를 거두었다. 그러나 이 같은 고율 관세와 수출 규제 강화는 미국 내 기업뿐 아니라 글로벌 반도체 생태계 전체에 시장 불확실성을 증폭시키며, 미국·중국·동맹국 간의 전략적 협상력 변화와 산업 경쟁 구도 재조정을 불가피하게 만들었다.

특히, 관세는 칩 완제품에 국한되지 않고 최종 조립국 규정, 공정용 화학·설비·원자재 등 밸류체인 전반에 확대 적용되어 '2차 비용(secondary costs)'을 끌어올렸다. 이로 인해, 수요 위축과 미국 내 생산원가 상승이 동시에 발생하고 있다. 품목별로도 영향이 다르게 나타나는데, 스마트폰·전기차(EV) 등 가격 탄력성이 큰 분야는 수요 감소 폭이 크고, 서버·산업용 반도체는 마진 악화와 밸류체인 재협상 압력이 심화되고 있다. **EMS 및 OSAT 등 후공정의 미국 이전은 인건비·운영비 상승과 인력 부족으로 인해 단기간 내 실현이 어려워, 미국 내 생산 확대의 구조적 병목으로 작용하고 있다**【McKinsey, 2025.05.27】.

또한, AI 가속기와 관련해 '확산(diffusion)' 및 '제3국 우회(diversion)' 리스크가 꾸준히 제기되어 왔다. 바이든 행정부 말기에 도입된 '확산 규정'은 동맹국 데이터센터로의 기술·장비 이전까지 광범위하게 적용되면서, 산업 활동 위축과 중국산 대체재 전환 가능성을 오히려 키웠다는 비판이 있었다. 이에 백악관은 **2025년 상반기부터 수출 통제 대상을 '우려국가(countries of concern)'로 한정하고, 동맹·파트너국에는 조건부 허용하는 방향으로 정책을 조정했다.** 이는 반도체 생태계의 연속성과 글로벌 공급망 안정성을 유지하기 위한 보완책으로 평가된다. 데이비드 섉스 백악관 보좌관은 "사우디와 같은 신뢰 가능한 파트너에 대한 확산은 리스크가 아니다"라고 밝히며, 승인된 운영자·데이터센터를 통한 접근 관리와 거래 승인 절차가 향후 관리의 핵심이 될 것임을 강조했다【Reuters, 2025.05.13】.

03.

2025년 상반기
반도체 시장
수급 불균형

Bottleneck

병목

AI 수요 폭증과
구조적 공급 병목

Polarization

양극화

수요 부진과
공급 과잉의 양극화

AI 수요 폭증과 구조적 공급 병목.

3.1. AI 수요 폭증과 구조적 공급 병목

2024년 글로벌 반도체 시장에서 인공지능(AI) 가속칩은 전체 반도체 매출의 약 20%를 차지하며, 핵심 성장 동력으로 부상했다. 특히 데이터센터용 반도체 매출 비중이 25%에 달하면서, AI 및 고성능 컴퓨팅(HPC)을 중심으로 반도체 수요 구조가 빠르게 전환되고 있음을 보여주고 있다. AI 가속칩 시장 규모는 2022년 2분기 약 2억 달러에서 2025년 2분기 약 6억 달러로 3배 이상 성장하였으며, 이와 같은 폭발적 수요는 반도체 산업 내 새로운 수요 축을 형성하고 있다【Morningstar, 2025.06.15】.

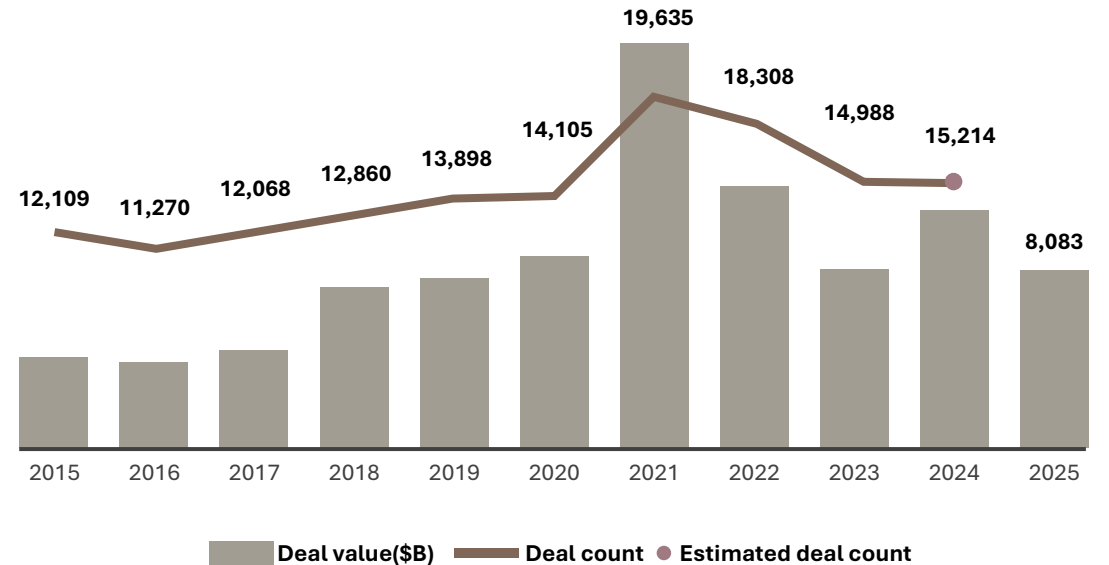
이러한 성장세의 중심에는 NVIDIA의 AI GPU 부문이 있다. NVIDIA는 2022~2025년 연평균 115%의 성장률(CAGR)을 기록하며 시장을 주도했고, AMD와 Broadcom 등 주요 팹리스 기업들도 30% 이상의 성장세를 나타냈다. 이에 대응해 TSMC는 2025년 4월 파운드리 가동률을 사상 최고 수준까지 끌어올려 전년 동기 대비 48%의 매출 성장을 달성했지만, 전체 수요를 충족하기에는 공급 역량에 한계가 있었다【Morningstar, 2025.06.15】.

03. 2025년 상반기 반도체 시장 수급 불균형

AI 수요 폭증은 기술기업뿐 아니라 벤처투자 시장까지 빠르게 확산되었다. 2025년 상반기 미국 내 AI 스타트업에 대한 벤처투자액은 전년 동기 대비 75.6% 증가한 1,628억 달러로, 전체 벤처딜 가치의 64.1%, 딜 건수의 35.6%가 AI 관련 기업에 집중되었다【Reuters, 2025.07.15】. 대규모 메가라운드 자금 유입은 AI 생태계 확장과 차세대 AI 가속칩 수요를 더욱 가속화시켰다.

이에 따라 반도체 기업들은 단기적으로 AI 고객 물량을 우선 배정하고, 고부가 AI 전용 장비 및 테스트 설비에 선제적 투자를 확대하는 한편, **벤처투자 흐름을 반영한 수요 예측 고도화로 공급 부족 완화**에 나서고 있다. 그러나 이러한 단기 대응만으로는 수요-공급 간 괴리를 해소하기에 충분치 않다. 중장기적으로는 웨이퍼 캐파 증설, 신규 첨단 팹 건설, CoWoS-FoWLP 등 고급 패키징 인프라 확충, 글로벌 OSAT 허브의 지역 다변화 등 다각적인 투자가 요구된다.

결과적으로 2025년 상반기 AI 수요의 폭증은 단순한 기술 트렌드를 넘어 반도체 산업 구조 자체의 전환을 촉진하고 있으며, 이를 둘러싼 펩리스-메모리-빅테크 간 전략적 공급망 협력은 향후 산업 경쟁력의 핵심 변수로 자리매김하고 있다.



H1 deal value buoyed by select AI megadeals 2025 (Source: PitchBook-NVCA Venture Monitor)

수요 부진과 공급 과잉의 양극화.

3.2 수요 부진과 공급 과잉의 양극화

2024년 하반기 이후, AI 및 고성능 컴퓨팅 반도체와 달리 범용 DRAM, NAND 플래시, 모바일 애플리케이션 프로세서(AP) 시장에서는 뚜렷한 공급 과잉과 수요 둔화가 나타났다. 글로벌 스마트폰·PC 출하량 둔화가 이어지면서 DRAM과 NAND 가격이 하락했고, 주요 공급사들의 누적 재고 부담이 심화되었다. 이에 따라 삼성전자, SK하이닉스, Micron 등 메모리 기업들은 감산과 신규 투자 보류 등 생산 조정에 나섰다【TrendForce, 2024.12.10; 2025.01.06】.

2025년 상반기부터는 이러한 공급사들의 조정과 재고 축소 노력이 점진적으로 효과를 내기 시작했다. TrendForce에 따르면 NAND 플래시 시장은 수급 균형을 점차 회복하고 있으며, 2025년 3분기에는 계약 가격이 전 분기 대비 최대 13% 상승할 것으로 전망된다【TrendForce, 2025.07.09】. 이는 공급사들이 수익성이 높은 고부가 제품 위주로 생산 역량을 재배분하고, 모듈 업체들의 과잉 재고 소진을 유도한 결과다.

03. 2025년 상반기 반도체 시장 수급 불균형

생산 전략 전환의 영향은 웨이퍼 공급 구조에도 나타난다. 공급사들은 저밀도·저수익 제품의 웨이퍼 생산을 축소하고 고수익 제품에 집중하며, 전체 생산량이 감소하는 흐름을 보이고 있다. 그 결과, 2025년 3분기 기준 3D NAND 웨이퍼의 평균 가격은 8~13% 상승할 것으로 예상되며, 이는 모바일 모듈 제조업체의 원가 부담으로 이어지고 있다.

결과적으로, 범용 메모리와 모바일 칩 시장은 2024년 하반기 이후의 공급 과잉 국면을 벗어나 **2025년 중반부터 점진적 수급 안정화와 가격 회복세가 관측된다. 다만 회복 속도와 강도는 AI 반도체 시장과 달리 제한적**이며, 주요 공급사들은 단기 수익성 방어와 고부가 제품 중심의 포트폴리오 재편에 집중하는 전략을 지속하고 있다.

	2Q25	3Q25
Emmc UFS	Up 5-10%	Up 0-5%
Enterprise SSD	Mostly flat	Up 5-10%
Client SSD	Up 5-10%	Up 3-8%
3D NAND Wafers (TLC & QLC)	Up 15-20%	Up 8-13%
Total NAND Flash	Up 3-8%	Up 5-10%

2Q25 – 3Q25 NAND Flash Price Projections (Source: TrendForce)

04. 글로벌 주요 기업의 전략적 대응



미·중 규제 리스크 속 'Sovereign AI' 전략으로 공급망·시장 구조 전환



GPU 수급 불균형 대응과 AI 인프라 내재화 가속



Tomahawk Ultra로 GPU 병목 해소 및 AI 네트워크 개방형 전환 선도



AI 추론 인프라 내재화 및 전력 자립화 전략



글로벌 확장과 OIP 네트워크로 공급망 재정의

4.1. NVIDIA: 미·중 규제 리스크 속 'Sovereign AI' 전략으로 공급망·시장 구조 전환

2025년 상반기, NVIDIA는 AI 플랫폼 확장과 공급망 리스크 분산이라는 복합적 과제에 대응하기 위해 전략적 전환을 단행했다. 핵심은 국가 및 초대형 고객이 자체적으로 AI 인프라를 구축할 수 있도록 지원하는 'Sovereign AI' 전략으로, 2024년 3월 GTC 기조연설에서 공식화된 이후 플랫폼-생산-클라우드의 유기적 연결을 기반으로 다층적 서비스를 갖추기 시작했다【NVIDIA GTC 2024 Keynote, 2024.03.19】.

이 과정에서 NVIDIA는 AI Foundry, NeMo, NIM, DGX Cloud 등 자사 핵심 솔루션을 결합하여, 고객이 데이터 준비부터 학습, 평가, 배포까지 AI 개발 전 과정을 원스톱으로 경험할 수 있도록 지원했다. 또한 Azure, Google Cloud 등 주요 퍼블릭 클라우드와의 통합을 강화함으로써, 글로벌 고객이 동일한 개발·운영 환경을 활용할 수 있게 했다【Microsoft Azure, 2025.03.18; NVIDIA Blog, 2025.05.27】.

한편, 2025년 들어 미국의 대중국 수출 규제와 H20 GPU 수출 중단으로 NVIDIA는 100억 달러에 가까운 매출 손실이 예상되었다【Zacks, 2025.07.09】. 이로 인해 NVIDIA는 공급망과 매출 구조의 지역 다변화를 적극 추진하게 되었다. 대표적으로 사우디아라비아 AI 팩토리 구축, 유럽 4개국의 AI 기가팩토리 투자, 대만 및 UAE 정부와의 협력, Foxconn과의 생산 제휴 등 글로벌 거점 확대에 나섰으며, 이러한 프로젝트에는 NVIDIA의 풀스택 기술이 적용되어 규제 회피와 진입장벽 강화라는 이중 효과를 노렸다.

이와 더불어, 2025년 4월에는 'Made-in-USA AI 슈퍼컴퓨터' 로드맵을 발표하고, 미국 내 최대 5,000억 달러 규모의 AI 인프라 생산을 공식화했다. 애리조나 TSMC 팹에서 Blackwell AI 칩 양산을 시작하고, 텍사스 지역에 Foxconn·Wistron과의 조립 라인을 신설해 단기간 내 대량 생산 체계를 구축하는 등, 미국 정부의 반도체 관세 정책 변화와 연동된 선제적 공급망 리스크 대응에 나섰다【CNBC, 2025.04.14】. 그러나 2025년 7월 미·중 희토류 협상 결과 H20 GPU가 수출 금지 리스트에서 제외되면서, NVIDIA는 하반기부터 중국향 H20 GPU 공급을 재개하고, 중국 특화 신제품(예: RTX Pro GPU) 설계를 통해 시장 방어와 점유율 회복에 나서고 있다【Reuters, 2025.07.16】. 젠슨 황 CEO는 "허가 범위 내에서 가능한 한 고성능 칩을 중국 시장에 공급하겠다"며 전략적 유연성을 강조했다.

종합하면, NVIDIA는 2025년 ①상반기 AI 인프라 플랫폼 주도권 강화, ②글로벌 공급망 분산, ③지정학 리스크 대응, ④규제 회피 전략 등 네 가지 축을 중심으로 공격적 확장과 방어적 유연성을 병행하는 전략을 구사했다. 이러한 일련의 조치는 AI 반도체 산업 내 NVIDIA의 구조적 우위와 장기 성장 동력을 더욱 공고히 하고 있다.

4.2. Amazon AWS: GPU 수급 불균형 대응과 AI 인프라 내재화 가속

2025년 상반기, AWS는 급격히 증가하는 AI 워크로드 수요와 심화되는 GPU 수급 불균형에 직면하였다. 2024년 하반기 이후 P5 인스턴스(H100 GPU 기반) 공급 부족이 본격화되면서 내부 프로젝트 지연과 GPU 자원 배분 갈등이 발생했고, 이는 엔비디아 의존 심화 및 AI 인프라 운영비용 상승으로 이어졌다. 이러한 위기 상황은 **AWS가 자체 AI 인프라 내재화와 수직 통합 역량 강화라는 전략적 전환을 추진하게 된 주요 계기**로 작용했다.

이에 따라 AWS는 2025년 6월 Graviton4(고성능 ARM 기반 CPU) 업그레이드, Trainium3(차세대 AI 가속기) 로드맵, Ultracluster(Trainium 기반 슈퍼컴퓨팅), Project Rainier(Anthropic용 AI 슈퍼컴퓨터) 등 일련의 하드웨어 및 인프라 혁신 프로젝트를 공식 발표했다【CNBC, 2025.06.17】. 이러한 전략의 배경에는 이미 2024년부터 실행된 **Project Greenland**가 있다. Greenland는 AWS 내 모든 GPU 자원을 중앙 통합 관리·배분하는 플랫폼으로, ROI 기반 우선순위 원칙에 따라 실시간 자원 회수와 최적화가 가능해졌고, GPU 수요 관리의 효율성을 크게 높였다【Business Insider, 2025.04.22】.

AI 훈련 인프라 확장에서는 **Project Rainier**가 핵심 역할을 담당했다. 수십만 개 Trainium2 UltraServer 칩을 EC2 UltraCluster에 연결한 대규모 분산 슈퍼컴퓨팅 아키텍처를 구현함으로써, 기존 대비 5배 이상의 훈련 성능을 달성하고, 초저지연 인터커넥트(NeuronLink v2) 도입을 통해 효율성과 확장성을 동시에 확보했다. 이처럼 자체 기술력을 바탕으로 한 인프라 혁신은 2025년까지 1,000억 달러 규모의 AI 인프라 투자 계획 추진을 뒷받침하고 있다【Amazon, 2025.06.24】.

물리 인프라 측면에서도 AWS는 자체 설계한 In-Row Heat Exchanger(IRHX) 냉각 시스템을 도입해, NVIDIA GB200 NVL72 GPU 랙 등 고밀도 AI 워크로드 환경에 최적화된 데이터센터 운영 역량을 확보하였다. 이 시스템은 공랭 대신 수냉 방식으로 고열·고전력 환경에 효과적으로 대응하며, 공간·물 사용량을 줄이는 동시에 고밀도 슈퍼컴퓨팅의 상용화를 지원했다【CNBC Insider, 2025.07.29】.

결과적으로, AWS의 일련의 전략은 단기적으로 GPU 수급 불균형과 AI 인프라 비용 문제 완화로 이어졌고, 중장기적으로는 ①**전용 칩 기반의 AI 인프라 자립 역량 확보**, ②**엔비디아 의존도 완화**, ③**핵심 고객에 대한 컴퓨팅 수요의 안정적 대응**이라는 전략적 성과로 귀결되고 있다. AWS는 앞으로도 전용 칩·수직 통합·하드웨어 설계 역량을 삼축으로 AI 인프라 독립성과 지속가능성을 한층 더 강화해나갈 전망이다.

4.3. Broadcom: Tomahawk Ultra로 GPU 병목 해소 및 AI 네트워크 개방형 전환 선도

2025년 상반기, Broadcom은 AI 인프라 내 최대 병목 요인으로 지적되어 온 GPU 간 연결 성능 한계를 해소하기 위해 차세대 네트워킹 반도체 SoC 개발에 역량을 집중했다. 그 결과 7월에는 **AI 네트워킹 시장 주도권 강화를 목표로 'Tomahawk Ultra'를 공식 발표했다.** 이 칩은 TSMC 5nm 공정 기반으로, 51.2Tb/s 스위칭·250ns 지연·로스리스 패브릭(LLR·CBFC)·소형 패킷 라인레이트 처리 등 첨단 기능을 탑재하여, 기존 NVLink Switch 대비 더 많은 칩을 연결할 수 있는 'scale-up' 시나리오를 제공한다【Reuters, 2025.07.15; Global News Wire, 2025.07.15】.

이러한 기술적 진보는 단순 속도 개선에 그치지 않고, AI 데이터센터 인프라의 개방형 전환을 위한 핵심 기반으로 작용하고 있다. Broadcom은 Google TPU 인터커넥트와 ASIC 공동설계 경험을 바탕으로 자체 'AI 패브릭' 포트폴리오를 구축하며, 이는 NVIDIA 중심 인프라의 실질적 대안으로 부상하고 있다. 결과적으로, Broadcom은 GPU 병목 해소, 네트워킹 최적화, 비(非)엔비디아 중심 생태계 확산이라는 세 가지 축을 중심으로 차세대 AI 인프라 시장에서 전략적 입지를 확대하고 있다.

한편, Broadcom은 기술적 공세와 병행해 지정학·정책 리스크에 대한 선제적 조정 전략도 추진하고 있다. 당초 스페인 내 10억 유로 규모 후공정 투자 계획은 트럼프 행정부의 해외 투자 견제, EU의 반도체 수입 관세(2025년 8월 시행), EU AI Act 및 DMA 등 복합 규제 리스크 등 외부 요인으로 2025년 상반기 중단되었다【Tech Research Online, 2025.06.14】. 이에 따라 Broadcom은 **자본 지출(CAPEX)을 전면 재조정해, 미주와 아시아의 고성장 AI 네트워킹 사업에 집중하고, 유럽 시장은 직접투자 대신 파트너십 기반 후공정 아웃소싱('asset-light') 전략으로 선회했다.**

이러한 전략적 변화는 고정비 부담을 최소화하는 동시에, 기술 리더십을 유지하려는 Broadcom의 사업 모델 최적화 방향성과 일치한다. 결국 Broadcom은 AI 인프라 전환기의 시장·정책 변화에 대응하여 ①**GPU 간 네트워킹 병목 해소를 위한 기술 주도**, ②**고비용·고위험 시장 회피 및 자원 집중**, ③**개방형 인프라 가속**이라는 세 축을 바탕으로 전략적 재편을 단행하고 있다. 이는 기술 경쟁의 최전선에 있는 NVIDIA 중심 구조에 도전하는 동시에, 지역별 정치 리스크에도 능동적으로 대응하는 다층적 접근으로 평가된다..

4.4. Google: AI 추론 인프라 내재화 및 전력 자립화 전략

2025년 상반기, Google은 폭증하는 LLM 및 실시간 AI 추론 수요와 데이터센터 전력 사용량 증가라는 이중 과제에 직면하였다. 이에 따라 Google은 **AI 가속기 칩 설계 내재화와 전력 인프라 투자를 병행하는 이중 전략을 본격화**했다. 이러한 전략적 방향 전환은, 추론 인프라의 확장성과 에너지 지속가능성 확보라는 복합 과제를 동시에 해결하기 위한 조치였다.

2025년 4월, Google은 7세대 인퍼런스 전용 AI 가속기인 '**Ironwood TPU**'를 공개하며, 자체 칩을 활용한 고성능·저지연 LLM 추론 환경을 실현했다【Google Cloud Blog, 2025.04.23】. Ironwood는 Cloud TPU v5p 기반 상용 서비스와 연동되어, NVIDIA GPU 기반 인프라의 대체재로 자리매김하고 있다. 이를 통해 Google은 추론 단계의 비용 효율화와 플랫폼 독립성을 동시에 추구할 수 있게 되었다.

한편, Google은 **AI 인프라의 에너지 자립과 지속가능성 확보를 위해 전력 인프라 투자에도 선제적**으로 나섰다. 2025년 7월, Google은 미국 PJM 전력망 13개 주에 250억 달러 규모의 AI 데이터센터 및 전력 인프라 투자 계획을 발표하고, 동시에 펜실베이니아 수력발전소 현대화(30억 달러) 프로젝트도 추진하였다【CNBC, 2025.07.15】. 이 프로젝트는 Brookfield와의 20년 장기 전력 구매계약(PPA)에 기반하며, Google의 AI 인프라가 RE100 기반 친환경 에너지로 운영되는 에너지-반도체 결합형 모델의 대표 사례로 평가된다. 또한 'AI Works for PA' 무상 교육·훈련 프로그램을 통해, 지역 일자리 창출과 전력망 안정성 강화라는 사회적 효과도 함께 추구하고 있다【McCormick Senate Fact Sheet, 2025.07.15】.

결과적으로, Google은 ①**자체 AI 가속기 경쟁력 강화**, ②**장기 전력 자립 인프라 구축**이라는 두 축을 기반으로 **칩-전력-운영 측면의 전략적 독립성을 확보**했다. 이는 AI 워크로드의 급격한 확장 and 탄소중립 달성이 동시에 요구되는 환경에서, Google만의 수직통합형 AI 인프라 경쟁력을 한층 강화하는 중장기 전략으로 평가된다.

4.5. TSMC: 글로벌 확장과 OIP 네트워크로 공급망 재정의

2025년 상반기, TSMC는 AI와 HPC 시장의 수요 폭증 및 미·중 기술 경쟁 장기화라는 복합적 도전에 대응하기 위해 **공급망의 지역 다변화와 첨단 생산역량의 글로벌 분산 전략**을 본격적으로 추진하였다. 이러한 전략적 변화는 미국 정부의 보조금 정책과 주요 고객사들의 안정적 공급망 요구가 맞물린 결과로, 미국 애리조나가 TSMC의 글로벌 전략에서 핵심 거점으로 부상하는 배경이 되었다. 그러나 미국 현지 3nm 생산라인 건설은 초기에 복잡한 허가 절차, 자재 병목 현상, 숙련 인력 부족 등으로 인해 가동이 지연되었고, 이로 인해 주요 고객사들의 우려가 고조되었다. 이에 따라 2025년 6월, TSMC는 미국 정부와의 협의를 통해 미국 내 투자 규모를 1,000억 달러 추가 확대하기로 결정하였으며, 기존에 발표된 CHIPS Act 보조금 66억 달러는 그대로 유지되는 방향으로 정리되었다【Reuters, 2025.06.04】.

이 같은 협의 과정을 거쳐 2025년 3월, TSMC는 트럼프 대통령과 함께 애리조나 신규 투자 계획을 공식 발표했다. 여기에는 3개의 신규 팹과 2개의 첨단 패키징 시설, 1개의 대규모 R&D 센터를 포함한 총 1,650억 달러 규모의 'Arizona GigaFab Cluster' 로드맵이 제시되었으며, 각 팹은 N4, N3, 2nm 등 첨단공정 생산에 초점을 맞추고 있다. 완공 이후에는 미국 내에서 2nm 이상 첨단공정 생산량의 약 30%를 담당하게 될 전망이다【TrendForce, 2025.07.17】.

TSMC는 **미국 외에도 유럽과 일본 등 전략적 생산거점 확장에 속도**를 내고 있다. 유럽에서는 2025년 5월, 독일 뮌헨에 유럽 최초의 칩 설계 지원 R&D 센터를 설립한다고 발표했으며, 드레스덴에서는 로버트 보쉬, 인피니언, NXP와의 합작을 통해 28nm 및 22nm 기반의 12인치 웨이퍼 생산 팹 건설이 진행 중이다【Taipei Times, 2025.05.29】. 일본 구마모토에서는 1공장이 2024년 말부터 가동을 시작했으며, 2공장은 올해 말 착공이 예정되어 있으나 실제 가동 시점은 고객 수요에 따라 조정될 예정이다. 이처럼 글로벌 생산거점 확대를 뒷받침하기 위해, **TSMC는 OIP(Open Innovation Platform) 생태계를 기반으로 IP, EDA(설계 툴), 첨단 패키징(CoWoS-InFO), 공정기술 협업 네트워크를 80개 이상의 글로벌 파트너로 확대**하였다. 미국 애리조나는 N4, N3E, 2nm 공정 등으로의 확장을 추진하고 있으며, 일본 구마모토는 12/16/22/28nm(1공장)과 6/7nm(2공장) 중심의 생산 역량 강화를 목표로 하고 있다【TrendForce, 2025.07.17】. 각 지역 팹은 Fab-to-Fab 기술 공유와 고객 맞춤형 공정 최적화 전략을 통해 시너지를 창출하고 있다.

결과적으로, TSMC는 미국을 중심으로 한 GigaFab 클러스터와 더불어 글로벌 주요 생산거점에서 AI와 HPC 분야의 대형 고객사를 확보하고, CHIPS Act 보조금 유치 및 전략적 고객사 신뢰를 강화하며, NVIDIA·AMD 등과의 첨단공정·패키징 공급 연계를 한층 강화하고 있다. 이러한 일련의 전략은 TSMC가 글로벌 파운드리 시장에서 첨단공정과 고급 패키징을 동시에 제공할 수 있는 유일한 공급자로서의 입지를 더욱 공고히 하는 계기가 되고 있다.

05. 분석 종합 및 함의

05. 분석 종합 및 함의

2025년 상반기 미국 반도체 산업은 정책의 **'재균형(Rebalancing)'**을 **중심축으로 재편**되고 있다. 보조금 정책은 '선택과 집중' 및 '조건부 매칭' 형태로 변화하면서, 민간 주도의 컴퓨팅 및 전력 인프라 확장이 제조 역량과 운영 기반(컴퓨팅·전력) 사이의 균형을 새롭게 정립하는 계기가 되고 있다. 동시에, '확산'과 '우회'를 차단하는 수출통제 강화와 최종조립국 기준의 관세 체계는 설계, 생산, 패키징, 조립 등 반도체 전 주기 밸류체인의 재배치를 촉진하고 있다.

이러한 **정책 환경 변화** 속에서, 규정 준수(Compliance)는 사후 대응이 아닌 설계 단계에서부터 내재화해야 하는 필수 요건으로 자리 잡았다. 그 결과, 미국 정부의 정책은 단일 해법이 아니라 ① 제조 내재화의 속도, ② 전력·냉각 인프라 확보, ③ 규정 준수형 거버넌스라는 세 축이 동시에 작동하는 새로운 '설계 원리'로 기능하고 있다.

시장 측면에서는 AI 및 HPC 중심의 견조한 수요와 함께, 메모리·모바일 부문의 완만한 회복이 병존하고 있다. 그러나 반도체 산업의 성패를 결정짓는 핵심 변수는 단순히 칩 설계 능력에 국한되지 않는다. 실질적으로 칩이 구동될 전력, 냉각, 데이터센터 인프라와, 이를 지원하는 첨단 패키징(CoWoS, FoWLP) 및 네트워킹(스위치·광연결) 확장 속도가 향후 시장 경쟁력의 핵심이 되고 있다.

특히, **관세와 수출통제의 재편**은 EMS(전자제조서비스)와 OSAT(후공정) 거점의 이동을 유발하고 있으며, 이 과정에서 화학, 설비, 부자재, 물류 등 2차 비용이 총소유비용(TCO)에 중첩되는 구조가 심화되고 있다. 이에 따라, 단기적으로는 첨단 패키징 리드타임과 전력·냉각 인프라 확보 속도가, 중기적으로는 정책 강도의 변화가 각 기업의 실적과 밸류에이션 변동성을 설명하는 핵심 변수로 부상할 가능성이 높다.

이 같은 **환경 변화 속에서 기업들**은 공급망 리스크를 완화하고 조달 안정성을 높이기 위해 멀티 파운드리 및 멀티 OSAT 전략을 강화하며, 생산 거점을 다변화하는 움직임을 가속화하고 있다. 또한, 주요 고객사와의 사전 협의를 통해 예약형 첨단 패키징 생산 능력을 적극적으로 활용하면서, 수요 변동과 리드타임 불확실성에 선제적으로 대응하고 있다. 아울러, 하이퍼스케일러 기업들은 컴퓨팅 자원뿐 아니라 이를 안정적으로 가동할 수 있는 전력·냉각 인프라 확보에도 주력하고 있다. 이를 위해 장기 전력구매계약(PPA) 체결, 송전망 확보, 수냉 및 액침 냉각 기술의 도입을 적극 추진하며, 자체 설계한 가속기와 개방형 네트워킹 기술의 활용 비중을 확대하고 있다. 이러한 노력은 특정 벤더에 대한 의존도를 낮추고, 전력·냉각·네트워킹을 포함한 전체 운영 기반 단위의 총소유비용(TCO)을 최적화하기 위한 전략적 대응으로 분석된다.

06.

참고문헌 및 출처

06. 참고문헌 및 출처

- Alper, Alexandra. “Trump Renegotiating Biden-Era Chips Act Grants, Lutnick Says.” *Reuters*, 4 July 2025, <https://www.reuters.com/world/us/trump-administration-renegotiating-overly-generous-biden-chips-act-grants-2025-06-04/>.
- Bhagat, Anirudha. “NVIDIA Bets on ‘Sovereign AI’—Will It Shield Against Trade War?” *Zacks Investment Research*, 9 Apr. 2025, <https://www.zacks.com/stock/news/2568804/nvidia-bets-on-sovereign-ai-will-it-shield-against-trade-war>.
- Broadcom Inc. “Broadcom Ships Tomahawk Ultra: Reimagining the Ethernet Switch for HPC and AI Scale-Up.” *GlobeNewswire*, 15 July 2025, <https://www.globenewswire.com/news-release/2025/07/15/3115637/19933/en/Broadcom-Ships-Tomahawk-Ultra-Reimagining-the-Ethernet-Switch-for-HPC-and-AI-Scale-up.html>.
- Cherney, Max A. “Broadcom Launches New Tomahawk Ultra Networking Chip in AI Battle against Nvidia.” *Reuters*, 15 July 2025, <https://www.reuters.com/business/broadcom-launches-new-tomahawk-ultra-networking-chip-ai-battle-against-nvidia-2025-07-15/>.
- Federal Register. “Implementation of Additional Due Diligence Measures for Advanced Computing Integrated Circuits; Amendments and Clarifications; and Extension of Comment Period; Correction.” *Federal Register*, 14 Feb. 2025, <https://www.federalregister.gov/documents/2025/02/14/2025-02655/implementation-of-additional-due-diligence-measures-for-advanced-computing-integrated-circuits>.
- Field, Hayden. “Nvidia to Mass-Produce AI Supercomputers in Texas.” *CNBC*, 14 Apr. 2025, <https://www.cnn.com/2025/04/14/nvidia-to-mass-produce-ai-supercomputers-in-texas.html>.
- Hadley, Linda. “Broadcom Scraps \$1B Spain Microchip Investment.” *Tech Research Online*, 14 June 2025, <https://techresearchonline.com/news/broadcom-scraps-1b-spain-microchip-investment/>.
- Hawkins, Mackenzie. “U.S. Plans AI-Chip Curbs on Malaysia, Thailand over China Concerns.” *Bloomberg*, 4 July 2025, <https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-07-04/us-plans-ai-chip-curbs-on-malaysia-thailand-over-china-concerns>.
- Hu, Krystal, and Niket Nishant. “U.S. AI Startups See Funding Surge While More VC Funds Struggle to Raise, Data Shows.” *Reuters*, 15 July 2025, <https://www.reuters.com/business/us-ai-startups-see-funding-surge-while-more-vc-funds-struggle-raise-data-shows-2025-07-15/>.
- Khan, Omar. “Microsoft and NVIDIA Accelerate AI Development and Performance.” *Microsoft Azure Blog*, 18 Mar. 2025, <https://azure.microsoft.com/en-us/blog/microsoft-and-nvidia-accelerate-ai-development-and-performance/>.
- Kim, Eugene. “‘Project Greenland’: How Amazon Overcame a GPU Crunch.” *Business Insider*, 22 Apr. 2025, <https://www.businessinsider.com/amazon-strategy-overcome-gpu-shortages-nvidia-2025-4>.
- Kimball, Spencer. “Google to Invest \$25 Billion in Data Centers and AI Infrastructure in PJM.” *CNBC*, 15 July 2025, <https://www.cnn.com/2025/07/15/google-to-invest-25-billion-in-data-centers-ai-infrastructure-in-pjm.html>.
- Kumar, Uttara. “NVIDIA and Google Partnership Gains Momentum with the Latest Blackwell and Gemini Announcements.” *NVIDIA Blog*, 27 May 2025, <https://blogs.nvidia.com/blog/nvidia-google-blackwell-gemini/>.
- Morningstar. “Q2 2025 Digital & Analog Semiconductor Industry Pulse.” *Morningstar*, 16 June 2025, <https://www.morningstar.com/business/insights/research/digital-and-analog-semiconductor-industry-pulse>.
- Novet, Jordan. “Amazon Web Services Builds Heat Exchanger to Cool Nvidia GPUs for AI.” *CNBC*, 9 July 2025, <https://www.cnn.com/2025/07/09/amazon-web-services-builds-heat-exchanger-to-cool-nvidia-gpus-for-ai.html>.
- NVIDIA. “GTC 2024 Keynote (S62542).” *NVIDIA On-Demand*, 19 Mar. 2024, <https://www.nvidia.com/en-us/on-demand/session/gtc24-s62542/>.
- Office of Senator Dave McCormick. “Fact Sheet—More than \$90 Billion in Investments Announced at Senator McCormick’s Pennsylvania Energy & Innovation Summit.” *U.S. Senate*, 15 July 2025, <https://www.mccormick.senate.gov/press-releases/fact-sheet-more-than-90-billion-in-investments-announced-at-senator-mccormicks-pennsylvania-energy-and-innovation-summit/>.
- Pan, Che, and Casey Hall. “Nvidia to Boost H20 Chip Sales to China after U.S. Export Restrictions Ease.” *Reuters*, 16 July 2025, <https://www.reuters.com/world/china/nvidias-huang-hails-chinese-ai-models-world-class-2025-07-16/>.
- Partsinevelos, Kristina. “AWS’ Custom Chip Strategy Is Showing Results, and Cutting into Nvidia’s AI Dominance.” *CNBC*, 17 June 2025, <https://www.cnn.com/2025/06/17/aws-chips-nvidia-ai.html>.
- PitchBook; National Venture Capital Association. Q2 2025 PitchBook–NVCA Venture Monitor. *PitchBook*, July 2025, <https://pitchbook.com/news/reports/q2-2025-pitchbook-nvca-venture-monitor>.
- Rodger, Kirsteen. “Meet Project Rainier, Amazon’s One-of-a-Kind Machine Ushering in the Next Generation of AI.” *About Amazon*, 24 June 2025, <https://www.aboutamazon.com/news/aws/aws-project-rainier-ai-tranium-chips-compute-cluster>.
- Shalal, Andrea. “U.S. Can Curb AI Chip Risks without Halting Tech Exports, U.S. Official Says.” *Reuters*, 13 May 2025, <https://www.reuters.com/world/middle-east/us-can-curb-ai-chip-risks-without-halting-tech-exports-us-official-says-2025-05-13/>.
- Streets, Madeleine. “Stargate AI Explained: What’s in the Project.” *TechTarget*, 20 Feb. 2025, <https://www.techtarget.com/whatis/feature/Stargate-AI-explained-Whats-in-the-project>.

06. 참고문헌 및 출처

- TrendForce. “Conventional DRAM Prices Plunge amid Oversupply, Raising Concerns for Taiwanese Firms.” *TrendForce*, 10 Dec. 2024, <https://www.trendforce.com/news/2024/12/10/news-conventional-dram-prices-plunge-amid-oversupply-raising-concerns-for-taiwanese-firms/>.
- TrendForce. “NAND and DRAM Supply–Demand Balancing Out.” *TrendForce*, 9 July 2025, <https://www.trendforce.com/presscenter/news/20250709-12638.html>.
- TrendForce. “Samsung, SK Hynix and Micron Reportedly Cut NAND Production amid Oversupply and Slow eSSD Demand.” *TrendForce*, 6 Jan. 2025, <https://www.trendforce.com/news/2025/01/06/news-samsung-sk-hynix-and-micron-reportedly-cut-nand-production-amid-oversupply-and-slow-essd-demand/>.
- TrendForce. “Tariff Effects on Foundries.” *TrendForce*, 9 June 2025, <https://www.trendforce.com/presscenter/news/20250609-12612.html>.
- TrendForce. “TSMC Accelerates 2nd Arizona Fab Production; Ramp-Up Schedules for Japan, Germany Undisclosed.” *TrendForce*, 17 July 2025, <https://www.trendforce.com/news/2025/07/17/news-tsmc-accelerates-2nd-arizona-fab-production-ramp-up-schedules-for-japan-germany-undisclosed/>.
- Vahdat, Amin. “Ironwood: The First Google TPU for the Age of Inference.” *The Keyword (Google Blog)*, 23 Apr. 2025, <https://blog.google/products/google-cloud/ironwood-tpu-age-of-inference/>.
- The White House. “ICYMI: President Trump Announces \$92 Billion in AI/Energy Powerhouse Investments.” *The White House*, 16 July 2025, <https://www.whitehouse.gov/articles/2025/07/icymi-president-trump-announces-92-billion-in-ai-energy-powerhouse-investments/>.
- The White House. “President Trump Solidifies U.S. Position as Leader in AI.” *The White House*, 15 July 2025, <https://www.whitehouse.gov/articles/2025/07/president-trump-solidifies-u-s-position-as-leader-in-ai/>.
- Wang, Lisa. “TSMC Plans New R&D Center in Germany.” *Taipei Times*, 29 May 2025, <https://www.taipetimes.com/News/front/archives/2025/05/29/2003837680>.
- Wiseman, Bill, et al. “The Effects of Tariffs on the Semiconductor Industry.” *McKinsey & Company*, 7 May 2025, <https://www.mckinsey.com/industries/semiconductors/our-insights/the-effects-of-tariffs-on-the-semiconductor-industry>.

본 리포트는 SIA, McKinsey & Company, Gartner, TrendForce, Reuters, CNBC, Bloomberg, PitchBook, Zacks Investment Research, TechTarget, Business Insider, GlobeNewswire, Taipei Times 등 주요 글로벌 리서치 기관 및 언론사와, NVIDIA, Intel, TSMC, Broadcom, Samsung, SK hynix, Micron, Google, Amazon, Microsoft, Oracle, Foxconn, SoftBank, Blackstone, CoreWeave, FirstEnergy 등 반도체 및 IT 주요 기업의 공식 자료와 보고서를 참고하여 작성되었습니다. 한.미 AI 반도체 혁신센터(K-ASIC)는 본 리포트에 포함된 정보의 정확성이나 완전성을 독립적으로 검증하지 않았으며, 제공된 정보의 신뢰성, 정확성 또는 완전성에 대해 어떠한 명시적 또는 묵시적 보증도 하지 않습니다. 본 리포트에 제시된 시장 전망, 분석 및 결론은 미래의 성과나 결과를 보장하거나 예측하는 것으로 해석되어서는 안 됩니다.

본 자료는 정보 제공을 목적으로 작성된 것이며, 투자, 사업, 또는 기타 의사결정을 위한 법적, 재정적, 또는 경영적 조언으로 간주될 수 없습니다. 한.미 AI 반도체 혁신센터와 그 자회사, 임원, 이사, 직원 또는 대리인은 본 리포트에 포함된 정보나 분석을 사용하거나 이에 의존함으로써 발생하는 어떠한 손실이나 피해에 대해서도 책임을 지지 않습니다. 리포트 이용자는 본 자료에 수록된 정보를 참고 목적으로만 활용해야 하며, 필요한 경우 반드시 별도의 전문가 자문을 구해야 합니다.



K·ASIC Korea AI & System IC
Innovation Center

Author

- Austin Jin | Manager, Strategy & Planning
- Jason Park | Strategy & Research Team

Research & Data

- Sungrok Kim | Strategy & Research Team